

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-03

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：电话会议
参与单位名称	前海开源基金、Willing Capital、明河投资、太平洋证券资管、信泰人寿、循远资管、北京源乐晟资管、北京沅沛投资、深圳熙山资管、上海度势投资、玄卜投资、泽铭投资、杭州拾年投资、上海吉渊投资、国海证券、长城证券、财通证券、华创证券、国投证券、东北证券、华安证券、东方财富、太平洋证券、国融证券、国信证券、天风证券
时间	2025 年 8 月 28 日 19:00—20:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈国兵 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	首先介绍了民德电子 2025 年半年度主要财务数据情况，随后介绍了公司目前主要业务的发展情况，最后对投资者关心的问题进行了解答。 一、公司财务情况介绍 （一）2025 年半年度主要财务数据情况 1、公司实现总营业收入 13,007.41 万元，较上年同期减少 3,084.58 万元，同比减少 19.17%，主要原因系非核心业务收入下降：（1）因广芯微电子有限公司纳入公司合并财务报表范围，与全资子公司民德（丽水）之间的设备租赁收入不再计入合并营业收入；（2）控股子公司君安技术公司的物流自动分拣设备业务订单与上年同期基本持平，受实施进度影响，收入较同期有所减少；（3）电子元器件分销公司泰博迅睿继续压缩业务规模，收入较上年同期有所下降。晶圆代工厂广芯微电子产能稳步提升，设计公司广微集成收入较上年同期翻番，公司的 AiDC 业务保持相对平稳发展。 2、公司实现归属上市公司股东的净利润 1,031.82 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,146.74 万元。主要原因系：（1）公司于 2025 年 1 月完

成对广芯微电子的控股收购，根据会计准则核算，公司合并广芯微电子产生了 5,099 万元的税后投资收益，是报告期内归属于上市公司股东的净利润及非经常性损益较上年同期增加的主要原因；（2）广芯微电子尚处于产能爬坡阶段，整体收入规模较小，且设备折旧摊销及人员等固定成本随着产能的提升较上年同期增加，导致广芯微电子仍处于亏损状态，净利润同比减少；（3）全资子公司泰博迅睿根据企业会计准则计提了一定金额的信用减值损失和资产减值损失，导致其净利润同比下降明显。公司的 AiDC 业务毛利率同比保持稳定，重要的参股企业晶睿电子和芯微泰克亏损合计同比收窄。

二、公司主要业务发展情况介绍

（一）功率半导体业务进展

功率半导体行业目前已出现较为明显的回暖迹象，公司产业链各环节业务较去年均有明显的进展和提升。

1、晶圆代工厂广芯微电子

广芯微电子处于良性扩产阶段，团队不断优化工艺平台能力，产品良率已处于业内较高水平，产销量不断提升，收入较上年同期大幅增长。

广芯微电子目前月产量已稳定在 2 万片以上，之前主要围绕生态圈内企业的产品，MOS 场效应二极管和高压 VDMOS 等，产出和良率已相对稳定；广芯微也在不断开发新的产品和客户，高压 BCD 产品和 TVS 产品正在开发中，近期每月均有新的客户导入。未来，广芯微将围绕良性扩产的核心任务，不断提升和优化工艺平台，服务更多优秀的设计公司。

2、设计公司广微集成

随着广芯微电子产能的支持，广微集成销售在不断恢复，产品已陆续通过客户验证，原有大客户开始批量下单，产品收入及毛利率同比增长，销售额逐步提升，经营情况得到逐步改善。广微集成也在不断开发应用于光伏、汽车等领域的新产品，其中，在广芯微电子代工的车规级 MFER 产品已开始持续向客户进行小批量供货，应用于光伏领域的 MFER 产品目前已完成试产。

3、特种工艺晶圆代工厂芯微泰克

芯微泰克已陆续与三十多家国内知名半导体设计公司和晶圆代工厂建立合作，并与数家企业建立长期战略合作，已量产 6/8 英寸的 IGBT、SGT、MOSFET 等功率器件背道工艺等多类产品，产品的销量稳步提升。

芯微泰克不断开发新工艺平台并提高技术水平，硅基晶圆减薄的键合工艺取得关键进展，已进行 Taiko 减薄 20 μm 和常规减薄 60 μm 先期测试，效果良好；同时，基于键合工艺的實現，目前正在开发超薄片（30 μm）晶圆的镀厚铜（30-50 μm）工艺，已完成前期方案设计，并成功获得相关发明专利；同时，8 英寸重金属掺杂工艺、SiC 薄片背道工艺等工艺也在陆续开发中。

4、晶圆原材料企业晶睿电子

晶睿电子发展势头良好，各个类型和尺寸的外延片销量均实现增长，其中主要产品 6 英寸外延片同比增长 11.26%，整体销售收入同比增长 17.31%；同时，晶睿电子不断优化产品结构，SOI、MEMS 传感器用双抛片、SiC 外延等高附加值产品已陆续实现量产，开始批量出货，已形成稳定收入。晶睿电子后续将在夯实目前的半导体市场业务基础上，重点发展应用于传感器市场的半导体材料，提升特色化和高端化水平，不断提升自身竞争力和业绩水平。

（二）AiDC 业务进展

报告期内，公司 AiDC 业务在复杂的国际环境下保持相对稳健发展，并维持较好的毛利率水平，为公司持续贡献稳定经营性现金流。公司始终坚持自主创新，AiDC 事业部不断提升产品技术水平和开拓产品应用领域，产品性能不断提升。后续，公司将在更多行业细分领域探索机器视觉类新产品和市场，与细分市场龙头企业深度合作，推出更多具有极致性价比和差异化功能的新产品。AiDC 业务未来也将长期作为公司“现金奶牛”业务，持续为公司提供资金和信用支持。

三、问答交流

1、AiDC 业务海外市场销售情况怎样，海外主要销往哪些国家？

答：2025 年上半年，公司 AiDC 业务在复杂的国际环境下保持相对稳健发展，并维持较好的毛利率水平，为公司持续贡献稳定经营性现金流。AiDC 业务海外销售占比超过六成，主要集中在俄罗斯、巴西、中东等“金砖国家”和“一带一路”沿线的国家或地区，并在不断开拓新的市场。

2、广芯微电子未来产品规划？

答：广芯微电子目前主要代工产品包括 45-200V 的 MOS 场效应二极管（MFER）、200-2,000V 的 VDMOS，同时，高压 BCD 产品和 TVS 产品正在进行开发。广芯微电子将持续开发针对高压、大电流的功率器件产品晶圆代工工艺，专注于汽车电子、能源革

	命、工业控制等应用领域，致力于推动芯片国产化，满足进口替代芯片的代工需求。 3、广芯微电子的扩产计划及进度？ 答：广芯微电子目前月产量已稳定在 2 万片以上，广芯微电子的定位为开放的晶圆代工厂，一期规划产能为 6 英寸硅基功率器件月产 10 万片，预计将于 2026 年底或 2027 年一季度实现满产。同时，广芯微电子现有场地有预留二期项目用地，待一期项目实现经营净现金流转正后，将适时启动二期项目建设。 4、公司对功率半导体 smart IDM 生态圈内三家生产企业剩余股权的计划？未来是否会继续投资其他功率半导体公司？ 答：晶圆代工厂是整个 smart IDM 生态圈中最重要的一环，也是公司构建长期护城河的核心战略资产。对于广芯微电子剩余股权，公司将根据广芯微电子的产能提升进度和情况，并结合上市公司股东利益最大化、广芯微电子经营团队激励机制有效性、资本市场情况等因素，适合启动对广芯微电子剩余股权的收购。对于晶圆原材料公司晶睿电子和功率器件特种工艺晶圆代工厂芯微泰克，公司将作为重要股东保持一定影响力，后续不会再增加资金投入。 投资方面，公司将持续关注特色功率半导体设计领域，对技术能力优秀的设计公司进行投资，并利用产业链进行赋能，帮助其做强做大，以不断壮大 smart IDM 生态圈。 5、广微集成的产品规划及应用领域？ 答：广微集成是一家功率半导体设计公司，目前核心产品为 45V-200V 全系列共一百余款型号的 MOS 场效应二极管（MFER），主要应用在机房电源、工业电机等对稳定性要求较高的应用场景。同时，广微集成也在不断开发应用于光伏、汽车等领域的新产品，其中，在广芯微电子代工的车规级 MFER 产品已开始向客户小批量持续供货，应用于光伏领域的 MFER 产品目前已完成试产。
附件清单（如有）	无
日期	2025-08-29